



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100430003
2011 年 5 月 13 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

PWR (パワーマネジメント) TLV700xxDSE製品 組立サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただきます。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -	
変更内容	PWR(パワーマネジメント) TLV700xxDSE 製品 組立サイト追加 現行 : UTAC2 社(タイ) 変更後 : UTAC2 社(タイ), HANA 社(タイ)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	6月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容：弊社 PWR(パワーマネジメント) TLV700xxDSE製品の組立サイトについて、現行 UTAC2社(タイ) サイトにおいて製造していますが、供給能力確保の為に、これに加えて、HANA社(タイ)サイトを追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立サイト	UTAC2 社(タイ)	UTAC2 社(タイ) HANA 社(タイ)

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
TLV70012DSER	TLV70015DSET	TLV70025DSER	TLV70028DSET	TLV70033DSER
TLV70012DSET	TLV70018DSER	TLV70025DSET	TLV70030DSER	TLV70033DSET
TLV70015DSER	TLV70018DSET	TLV70028DSER	TLV70030DSET	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L, 23L)が各々下記のようにになります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)	組立国コード(23L)
現行	UTAC2	ASO: NS2	ACO: THA
追加認定	HANA-Thailand	ASO: HNT	ACO: THA



図1 出荷ラベルの例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年1月7日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLV70007DSE	Die Protective Coating:	10KA CN	
Assembly Site:	HANA - HNT	Package/Code/Pins:	SON/DSE/6	
Mount Compound:	SID#400173	Mold Compound:	SID#450176	
Bond Wire:	0.8 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Electrical Characterization	Full Temperature		Approved	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles		77/0	
Visual / Mechanical	-		Approved	
Solderability	Steam age, 8 hours		22/0	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		10/0	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Ball Bond Shear	5 units, >76 balls, 0 fails		76/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C		12/0	
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年1月7日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLV70028DSE	Die Protective Coating:	10KA CN	
Assembly Site:	HANA - HNT	Package/Code/Pins:	SON/DSE/6	
Mount Compound:	SID#400173	Mold Compound:	SID#450176	
Bond Wire:	0.8 mils, Au	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles		80/0	
Visual / Mechanical	-		Approved	
Solderability	Steam age, 8 hours		22/0	
Physical Dimensions	per mechanical drawing		5/0	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Ball Bond Shear	5 units, >76 balls, 0 fails		76/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C		12/0	
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	—	終了 2011年1月7日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qual Device:	TLV70048DSE	Die Protective Coating:	10KA CN
Assembly Site:	HANA - HNT	Package/Code/Pins:	SON/DSE/6
Mount Compound:	SID#400173	Mold Compound:	SID#450176
Bond Wire:	0.8 mils, Au	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	Note
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77/0	(1)
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	-
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	80/0	-
**Steady State Life Test	140C, 480 Hrs	Approved	(1)
ESD HBM	2000V	3/0	(1)
ESD CDM	500V	3/0	-
Visual / Mechanical	-	Approved	-
Solderability	Steam age, 8 hours	22/0	-
Physical Dimensions	per mechanical drawing	10/0	-
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	-
Ball Bond Shear	5 units, >76 balls, 0 fails	76/0	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	-
**Thermal Shock	500 Cycles	77/0	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0	-
FTY and Bin Summary	-	Approved	-
Notes:			
** Preconditioning sequence, JEDEC L-1/260C			
(1) TLV70048DSE qual data at NSE has been utilized			